# PCB工艺要求

层数：6

制作数量(拼板后)：20 pcs

最小线距 4mil；最小线宽 4mil

最小钻孔 0.2mm/0.4mm

钻孔类型：通孔

钻空孔处理方式：树脂塞孔表面镀平

孔壁铜厚：满足IPC 2级标准(min 18um; typ 20um)

表面处理：沉金

阻焊颜色：黑色亚光

丝印颜色：默认(白色)

阻焊桥处理：厂家根据实际加工能力可以不做小于工艺能力的阻焊桥，需要在工程确认时对光绘文件改动进行确认。

PCB尺寸（拼板后）：75.3mm×94.2mm

测试

四线过孔测试，飞针测试，通断测试等常规测试

提供出货报告

公差

板厚公差：±10%

板外形公差：±0.1mm

翘曲度（整版，以对角线参考）：≤1%

设计文件格式：Gerber文件

Gerber文件板层顺序和层压结构：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gerber文件名** | **层功能描述/板材** | **厚度** |  |
| xxx\_Edge\_Cuts.gbr | 工艺层:PCB外框 |  |  |
| xxx\_F\_Silkscreen.gbr | 工艺层:顶层丝印 |  | 3，4 |
| xxx\_F\_Mask.gbr | 工艺层:顶层阻焊层掩膜 | 约1mil |  |
| xxx\_F\_Cu.gbr | 顶层铜层 | 1Oz | 完成铜厚>35um |
| Prepreg | 介质层/FR4 | 0.1mm | 1, 2 |
| xxx\_In1\_Cu.gbr | 内部铜层 | 1Oz |  |
| Core | 介质层/FR4 | 0.2mm | 1, 2 |
| xxx\_In2\_Cu.gbr | 内部铜层 | 1Oz |  |
| Prepreg | 介质层/FR4 | 0.127 | 1, 2 |
| xxx\_In3\_Cu.gbr | 内部铜层 | 1Oz |  |
| Core | 介质层/FR4 | 0.2mm | 1, 2 |
| xxx\_In4\_Cu.gbr | 内部铜层 | 1Oz |  |
| Prepreg | 介质层/FR4 | 0.1mm | 1, 2 |
| xxx\_B\_Cu.gbr | 底层铜层 | 1Oz | 完成铜厚>35um |
| xxx\_B\_Mask.gbr | 工艺层:底层阻焊层掩膜 | 约1mil |  |
| xxx\_B\_Silkscreen.gbr | 工艺层:底层丝印 |  | 3，4 |
| 总厚度 |  | 1mm |  |

1. 实际层压可以根据工艺微调，并在工程确认中反馈
2. 需要在工程确认中确认实际使用板材种类
3. 请勿在丝印层上添加厂家丝印，客编等源Gerber中没有的图形
4. 如果有丝印层和阻焊层开窗冲突的，去除冲突部分丝印层图案

钻孔文件：

xxx\_NPTH.drl – NPTH钻孔

xxx\_PTH.drl – PTH钻孔

xxx\_NPTH\_map.ps – NPTH钻孔描述

xxx\_PTH\_map.ps – PTH钻孔描述

钢网使用无边框钢片，将**拼板后**正反面（B\_Paste层，F\_Paste层）拼在同一张钢网上

钢网文件：

xxx\_B\_Paste - 底层钢网

xxx\_F\_Paste - 顶层钢网

拼板：

Gerber文件需要按板框标识层进行拼板，每4个单元板构成一个拼板。

图形用户界面

描述已自动生成

备注：

接受拼板打叉板，但需要按子板单元总数满足数量要求

需要工程/光绘确认完毕后再开料生产